**Исследование динамики процесса СВЧ плазменного удаления фоторезистивных защитных пленок в технологии интегральных микросхем**

**Бордусов С.В.**

**Мадвейко С.И.**

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

**Аннотация.** Представлены результаты анализа динамики удаления фоторезистивных плёночных защитных покрытий в объеме плазмы СВЧ разряда в кислороде и характера изменения интенсивности свечения спектральной линии ОI (λ=844,6 нм), используемой для контроля за удалением фоторезиста в случае обработки большого количества кремниевых пластин. Полученные результаты позволяют дополнить феноменологическую модель процесса плазмохимической деструкции фоторезистивных плёнок в объёме кислородной плазмы СВЧ разряда.

**Ключевые слова:** СВЧ, плазма, фоторезист